

## 陶瓷垫块/功率热沉/安装基座

产品名称	陶瓷垫块/功率热沉/安装基座
公司名称	浙江双芯微电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市德清县新市镇环北路283号2#厂房
联系电话	15868238095

## 产品详情

特点及用途：

氮化铝、氧化铝、金刚石等材料热沉的应用可提升散热能力，减少热阻，提高激光器输出功率，延长激光器寿命。陶瓷热沉可用半导体的制作工艺在陶瓷基板上形成薄膜金属材料，在热沉上可以进行划线，其表面金属化为Ti、Pt、Au、Cr、Cu、Sn、Ag或AuSn焊料等，厚度和成分都可进行定制。

近年来，随着需求升级，激光器芯片小型化发展趋势明显，但小型芯片散热量低，工作和不工作的热沉温差小，热匹配要求较低，可采用氮化铝材料作为基板与芯片相连。在电子封装领域，热沉主要是指微型散热片，用来冷却电子芯片的装置，是核心元器件之一。陶瓷热沉可满足高功率半导体激光芯片键合的需求，在光通信、高功率LED封装、半导体激光器、光纤激光器泵浦源制造等领域应用前景广阔。